

各位

2024年12月11日
太陽ホールディングス株式会社

太陽ホールディングス「SEMICON Japan 2024」出展のお知らせ

imecと共同開発中の半導体ウエハレベルパッケージ用絶縁材料や 高透明・高耐熱PFASフリーフィルム含む最新の研究開発製品を展示

太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤 英志、証券コード：4626、以下、「太陽ホールディングス」）は、2024年12月11日（水）～13日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される、SEMICON Japan 2024に出展します。ブース内では、太陽ホールディングス研究部門の取り組み、半導体ウエハレベルパッケージの高解像度感光性絶縁材料や高透明・高耐熱PFASフリーフィルムをはじめとする、最先端技術の発展に貢献する各種研究開発品を展示します。



■「SEMICON Japan 2024」開催概要

開催期間：2024年12月11日（水）～13日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 東1ホール

小間番号：1538

展示会詳細：<https://www.semiconjapan.org/jp>

当社出展概要：<https://x.gd/q5Sh6>

主な展示内容：高解像度感光性絶縁材料、高耐熱・高解像度フォトレジスト、高透明・高耐熱PFASフリーフィルム

■出展製品情報

【高解像度感光性絶縁材料①】

製品概要：高解像度、高絶縁信頼性を持つ、低温硬化、アルカリ現像タイプの絶縁材料。

用途：次世代再配線層

【高解像度感光性絶縁材料②】 ※imec共同開発品:世界最大級の半導体研究機関imecの3Dプログラムへ参加し、RDL微細化の共同開発をしています。

製品概要：プロセス適応性と面内均一性、高解像性を持つ、アルカリ現像タイプの絶縁材料。

用途：再配線層用絶縁膜

【高耐熱・高解像度フォトレジスト】

製品概要：高耐熱、高解像性を持つネガ型感光材、アルカリ現像型のフォトレジスト。

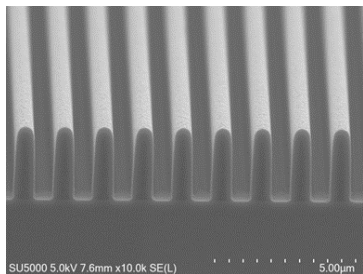
用途：パワー半導体製造工程

【高透明・高耐熱PFASフリーフィルム】

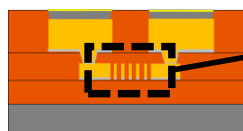
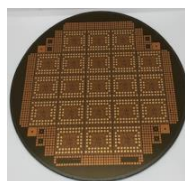
製品概要：PFAS不使用、高耐熱性、無色透明性、耐衝撃性を持つフィルム。

用途：透明FPC、フレキシブル太陽電池、スマートグラス、タッチセンサー

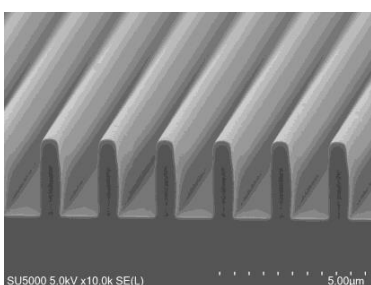
■参考写真



高解像度感光性絶縁材料



高解像度感光性絶縁材料



高耐熱・高解像度フォトレジスト
(イオン注入後のレジスト形状)



高透明・高耐熱PFASフリーフィルム

【製品に関するお問い合わせ先】

太陽ホールディングス株式会社 研究本部

https://cloud.swcms.net/taiyo-hdPublic/form/ja/agree_08/inquiry_08.html